

(参考) Beyond 2nmの次世代半導体の確保

- 半導体トップメーカーを有する米国、韓国、台湾に加えて、欧州もドイツにIntelの工場を誘致するなど、世界中で次世代半導体の開発が加速。
- 最先端半導体はFin型からGAA型に構造が大きく変わり、量産に向けて高度な生産技術が必要となる転換期。
- 10年前にFin型の量産に至らなかった日本が改めて次世代半導体に参入するラストチャンス。
- その実現には、TSMC誘致、拠点拡大によるキャッチアップを進めるとともに、10年の遅れを取り戻す、これまでとは異次元の取組が必要。

実用化ロードマップ (★ : GAA構造)

intel	【米国】 4nm '22年 3nm '23年 ★20A '24年 18A '24年	【ドイツ】 '27年 生産開始
	【台湾】 3nm '22年 ★2nm '25年	
	【韓国】 ★3nm '22年 2nm '25年	

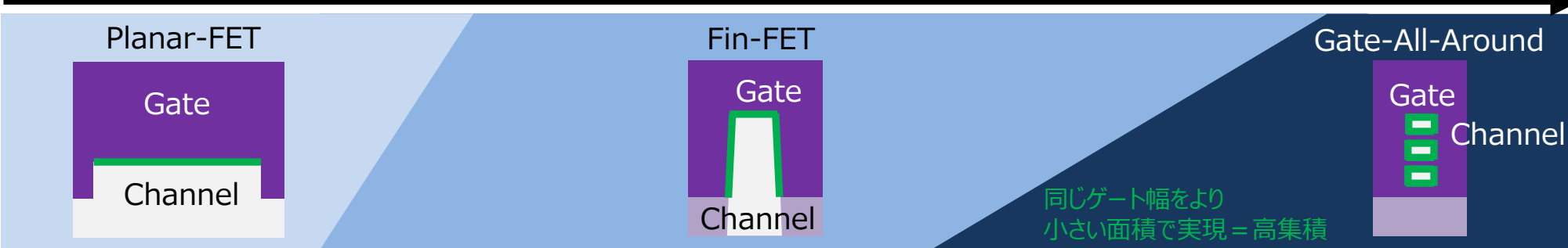
世界からは10年遅れ
先端ロジック分野では後進国

- 課題
- ・次世代半導体を活用したユースケース開発
 - ・次世代半導体開発・製造知見の確立
 - ・半導体関連産業を支える人材の教育

次世代半導体の確保にどのように取り組むか

JASM熊本の誘致によりキャッチアップ

ルネサス



海外



国内

